

Plaskon 3400F-14

Epoxy; Epoxide

Cookson Electronics - Semiconductor Products

Описание материалов:

This material is a fast curing, reduced-stress epoxy molding compound for the encapsulation of semiconductor devices including DIPs, PLCCs, SOICs and medium lead count QFPs. It was developed with fine filler particles especially for use with automated or conventional molding equipment and offers a balance of end use properties.

Главная Информация			
Характеристики	Полупроводникового Лазерная маркировка Цикл быстрого формования Ускоренная Настройка Хорошая производительность формования Отличный внешний вид		
Формы	Жидкость		
Метод обработки	Литье из смолы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.80	g/cm ³	ASTM D792
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль	1.52	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	0.0124	MPa	ASTM D790
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура перехода стекла	150	°C	ASTM E1356
CLTE-Поток	2.1E-5	cm/cm/°C	ASTM D696
Теплопроводность	16	W/m/K	ASTM C177
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопротивление громкости	1.6E+16	ohms-cm	ASTM D257
Диэлектрическая прочность	16	kV/mm	ASTM D149
Диэлектрическая постоянная (1 kHz)	3.80		ASTM D150
Коэффициент рассеивания (1 kHz)	2.0E-3		ASTM D150
Дуговое сопротивление	180	sec	ASTM D495
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость (3.18 mm)	V-0		UL 94
Индекс кислорода	32	%	ASTM D2863
Дополнительная информация			

Recommended Storage Temperature: 5°C Life @ 5°C, defined as not more than 40% loss of spiral flow based on original values.: 24 months Life @ 21°C, defined as not more than 40% loss of spiral flow based on original values.: 5 days Life @ 35°C, defined as not more than 40% loss of spiral flow based on original values.: 2 days Spiral Flow, 177°C, 1000 psi: 54 to 78 cm Automatic Orifice Viscosity, 175°C, 1000 psi, 1 mm die length, 1/2 mm diameter: 10 to 16 Pascal sec Ram Follower Gel Time, 177°C: 8 sec Ash Content: 71.4 % Hydrolyzable Halides: <10 ppm Cull Hot Hardness, Shore D, 90 sec, 175°C: 70 Arc Resistance, 110v AC 180 sec All test specimens are transfer molded and post cured for 4 hours at 175°C
Linear Thermal Expansion, Alpha 1: 21 cm⁻⁶/cm/°C
Linear Thermal Expansion, Alpha 2: 60 cm⁻⁶/cm/°C

Инструкции по впрыску

Resin Transfer Molding:

Molding Temperature: 170 to 185°C

Molding Pressure: 750 to 1000 psi

Cure Time, 177°C: 20 to 26 min

Post Mold Cure Time, 175°C: 4 to 12 hr

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

